

中国硅酸盐学会

中硅字(2025) 09 号

第 15 届无机非金属材料专题研讨会 暨无机非金属材料学科优秀学者论坛 第二轮通知

为了促进学科繁荣与发展,充分发挥中国硅酸盐学会的学术交流优势和《硅酸盐学报》、*Journal of Materiomics*、*Advanced Materials Joining* 及《材料科学与工艺》作为开展学术交流、学术争鸣重要园地的作用,第 15 届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀学者论坛将于 2025 年 8 月 13 日~15 日在黑龙江省哈尔滨市举办。本届研讨会由中国硅酸盐学会主办,哈尔滨工业大学、材料结构精密焊接与连接全国重点实验室、特种环境复合材料技术国家级重点实验室、先进结构功能一体化材料与绿色制造技术工信部重点实验室、中材高新氮化物陶瓷有限公司承办。

一、研讨主题

先进结构陶瓷与复合材料、光电信息材料与器件、材料连接与电子封装、陶瓷涂层与薄膜材料、压电铁电与多铁性陶瓷、低维材料与器件、能量转换和存储材料与器件、生物医用与仿生材料、先进玻璃材料、先进晶体材料、高压与超硬材料、先进土木工程材料、先进耐火材料与陶瓷膜、人工智能辅助材料研究。

二、会议时间及地点

1、报到时间及地点：

8月13日全天，哈尔滨华旗饭店。

2、会议日期及地点：

8月14日8:30~18:00，8月15日8:30~17:00，哈尔滨华旗饭店。

3、会议住宿：

哈尔滨华旗饭店及周边协议酒店（马迭尔民防商务酒店、希尔顿酒店、悠融酒店等）。

三、会议组织

大会主席：

高瑞平（中国硅酸盐学会理事长）

南策文（中国硅酸盐学会副理事长，中国科学院院士，
清华大学教授）

周 玉（中国硅酸盐学会副理事长，中国工程院院士，
哈尔滨工业大学教授）

张清杰（中国科学院院士，武汉理工大学教授）

执行主席：

晋占平（中国硅酸盐学会副理事长）

贾德昌（哈尔滨工业大学特种陶瓷研究所所长，先进
结构功能一体化材料与绿色制造技术工信部重
点实验室主任，教授）

黄陆军（哈尔滨工业大学材料科学与工程学院院长，教授）

张幸红（哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所所长，
特种环境复合材料技术国家级重点实验室副主任，
教授）

组委会秘书长:

曹淑凤(中国硅酸盐学会编辑部主任)

王玉金(哈尔滨工业大学材料结构精密焊接与连接国家重点实验室副主任,教授)

林铁松(哈尔滨工业大学材料结构精密焊接与连接国家重点实验室常务副主任,教授)

王亚明(哈尔滨工业大学特种陶瓷研究所副所长,先进结构功能一体化材料与绿色制造技术工信部重点实验室副主任,教授)

四、分会场设置

第 1 分会场:先进结构陶瓷与复合材料。主席:张联盟、董绍明、傅正义、成来飞、江莞、付前刚、王玉金、杨金山、黄小萧、邹冀。

第 2 分会场:光电信息材料与器件。主席:祝世宁、刘益春、徐海阳、陈延峰、李亮、解荣军、翟天佑、杨彬。

第 3 分会场:材料连接与电子封装。主席:冯吉才、陈辉、李永兵、何鹏、占小红、田艳红、林铁松、宋晓国、杨治华。

第 4 分会场:陶瓷涂层与薄膜材料。主席:官声凯、李贺军、郭洪波、王京阳、吴晓宏、汪爱英、王传彬、张雨雷、张涛、杨冠军、王亚明。

第 5 分会场:压电铁电与多铁性陶瓷。主席:周济、李敬锋、汪宏、吴迪、林媛、李飞、殷月伟、常云飞。

第 6 分会场:低维材料与器件。主席:张跃、狄增峰、任文才、廖庆亮、刘开辉、曾海波、何军、周鹏、王欣然、胡平安、张铮。

第 7 分会场:能量转换和存储材料与器件。主席:张清杰、

成会明、陈立东、张文清、林元华、麦立强、胡勇胜、余彦、隋解和、徐成彦、康卓、王家钧。

第 8 分会场：生物医用与仿生材料。主席：王迎军、侯仰龙、刘绍琴、刘宣勇、杨洋、宁聪琴、邹朝勇、步文博、施雪涛、杨飘萍、李保强。

第 9 分会场：先进玻璃材料。主席：彭寿、杨中民、岳远征、韩高荣、邱建荣、张勤远、张龙、刘超、曹欣。

第 10 分会场：先进晶体材料。主席：杨德仁、胡章贵、杨春晖、介万奇、潘世烈、朱嘉琦、叶宁、苏良碧、于浩海、田浩。

第 11 分会场：高压与超硬材料。主席：田永君、刘冰冰、单崇新、龙有文、刘畅、姚明光、赵智胜、赵延军、曾桥石。

第 12 分会场：先进土木工程材料。主席：缪昌文、刘加平、邢锋、李惠、胡曙光、余其俊、程新、史才军、王发洲、郅晓、张云升、刘铁军、卿龙邦。

第 13 分会场：先进耐火材料与陶瓷膜。主席：李红霞、袁林、李亚伟、金胜利、侯新梅、李享成、常启兵。

第 14 分会场：第三届无机非金属材料学科优秀学者“自立自强”论坛（会议主题：AI for Materials）。召集人：沈洋、张幸红。

五、会议注册

1、网络注册



请扫描中国硅酸盐学会会员之家
小程序注册参会

请登录以下网址<https://inmc15.ceramsoc.com/>或扫描二维码进行会

议注册、提交摘要和缴费。

2、注册费

2025年7月31日(含7月31日)前支付, 2200元/人(在校学生1200元/人); 2025年8月1日后或现场支付, 2500元/人(在校学生1500元/人)。

六、论文征集

1、征文范围

征文包括但不限于以下内容: 先进结构陶瓷与复合材料、光电信息材料与器件、材料连接与电子封装、陶瓷涂层与薄膜材料、压电铁电与多铁性陶瓷、低维材料与器件、能量转换和存储材料与器件、生物医用与仿生材料、先进玻璃材料、先进晶体材料、高压与超硬材料、先进土木工程材料、先进耐火材料与陶瓷膜、人工智能辅助材料研究等。

2、摘要收集

研讨会面向无机非金属材料领域青年学者征集口头报告、墙报。口头报告摘要收稿起止日期: 2025年4月11日至2025年7月10日; 墙报摘要收稿起止日期: 2025年4月11日至2025年7月25日。请登录<https://inmc15.ceram soc.com>在线提交摘要。

截止日后, 口头报告摘要由组委会审核, 审核通过的摘要会以邮件通知学者, 审核未通过的摘要可转为墙报展示。墙报摘要无需审核, 可自行携带至会场展区展示。

3、正文投稿

参加研讨会交流并提交全文的论文经评审合格后, 择优在*Journal of Materiomics*和《硅酸盐学报》上刊发。

全文投稿请登录期刊网站:

Journal of Materiomics

(<http://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-materiomics>)

《硅酸盐学报》(<https://jccsoc.cbpt.cnki.net>)

七、会议食宿

1、酒店预订

请扫描以下二维码预订会议协议酒店：



请扫描预订会议协议酒店

(会议房间有限，请确认参会后及早预订，
酒店预定将于7月20日起改为电话预约)

2、会议期间食宿费用自理

八、会议联系

中国硅酸盐学会：

周立忠 (13522585433, zhoulizhong2010@163.com)

张津溥 (13671252214, zhangjinpu@jccsoc.com)

哈尔滨工业大学：

学术联系人：

段小明 (13804515316, duanxiaoming@hit.edu.cn)

陈 磊 (13258668288, chenleihit@hit.edu.cn)

蔡德龙 (18345171718, dlcai@hit.edu.cn)

会务联系人：

俞雪勇 (13556018157, 68844061@qq.com)

